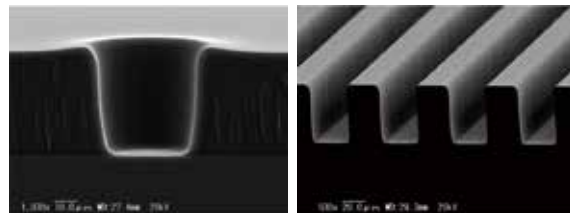


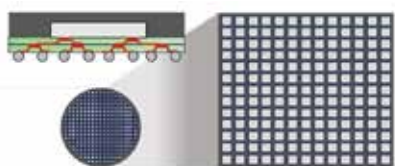
8 感光性接着剤 VPA series

半導体パッケージ製造工程用 仮接着材

- 強い接着力を有するネガタイプのレジスト(接着剤)
- レーザーアブレーションで容易に剥離可能
- 硬化膜は高い絶縁性と耐熱性を示す

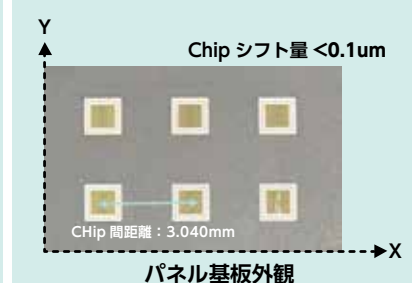
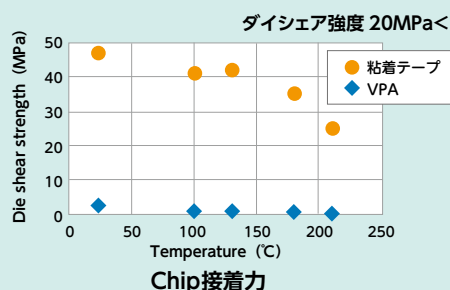
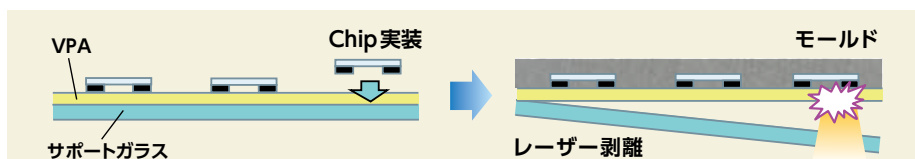


Fan-Out Package



高耐熱、高接着性により、
モールド時のChipシフトを抑制

優れた実装精度を実現

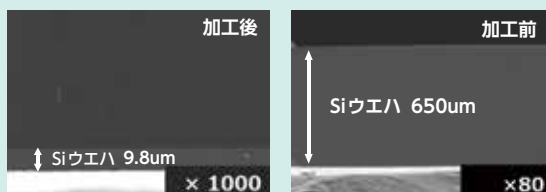
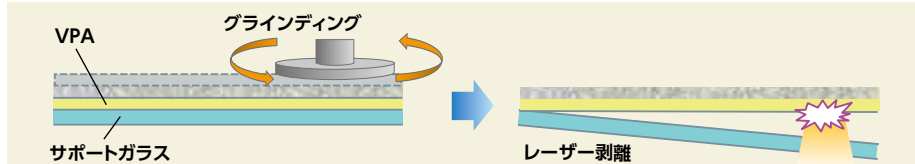


TSVウエハグラインディング

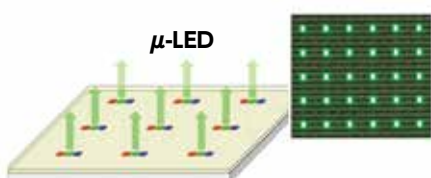


高充填、高接着性により、
グラインディング時、
クラックの発生を抑制

ウエハの薄化が可能

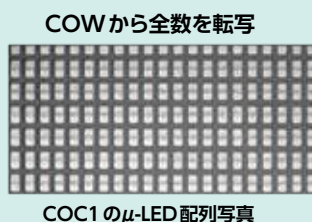
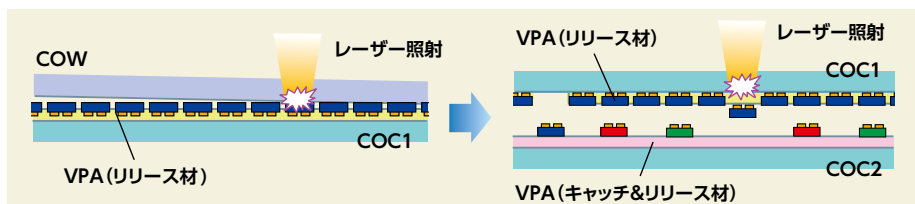


μ-LEDのレーザー転写



レーザーリリース性、高接着性、
高いLEDキャッチ性

優れたLED転写精度を実現



TORAY
Innovation by Chemistry

東レエンジニアリングと提携しプロセス開発中